

Diário Oficial Nº 103, sexta-feira, 31 de maio de 2013

### CONSULTA PÚBLICA Nº 14, DE 28 DE MAIO DE 2013

A Secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração de Processo Produtivo Básico - PPB.

Manifestações podem ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, ao e-mail: [cgel.ppb@mdic.gov.br](mailto:cgel.ppb@mdic.gov.br).

HELOÍSA REGINA GUIMARÃES MENEZES

ANEXO

PROPOSTA Nº 075/2012 - FIXAÇÃO DE PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA IMPRESSORAS DO TIPO MATRICIAL DE IMPACTO:

OBS : A Proposta está em formato de minuta de Portaria (Versão Lei de Informática).

Art. 1º Estabelecer para o produto IMPRESSORAS DO TIPO MATRICIAL DE IMPACTO, o seguinte Processo Produtivo Básico:

- I - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;
- II - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e
- III - integração das placas de circuito impresso e das demais partes elétricas e mecânicas na formação do produto final, montadas de acordo com os incisos I e II acima.

§ 1º Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, no País, exceto a etapa descrita no inciso III que não poderá ser objeto de terceirização.

Art. 2º Ficam temporariamente dispensados de montagem os seguintes módulos ou subconjuntos:

- I - cabeça de impressão sem o servo-mecanismo;
- II - mecanismo impressor com largura de impressão de até 6 (seis) cm;
- III - mecanismo impressor/leitor motorizado de bilhete magnético;
- IV - módulo de comunicação Bluetooth próprio para conexão à placa de circuito impresso através de processo de montagem por superfície - SMT (Surface Mounted Technology);
- V - módulo display de cristal líquido - LCD, com placa de controle integrada;
- VI - módulo leitor de cartão inteligente - smart card;
- VII - módulo, dispositivo ou subconjunto de mostrador de cristal líquido, plasma ou diodo emissor de luz - LED e outras tecnologias de displays;
- VIII - módulo sensor biométrico;
- IX - painel de operação e controle para impressoras, mesmo incorporando dispositivo de visualização;

X - os leitores de cartão de memória e as placas e partes eletromecânicas sem função ativa, com ou sem filtros de sinal, com objetivo de suportar mecanicamente conectores, entradas de USB, diodos emissores de luz - LED (Light Emitting Diode), chaves ligadesliga ou cabos, utilizados unicamente como extensão de função já implementada na placa-mãe.

§ 1º As fontes de alimentação ou conversores de corrente contínua (CA-CC), destinadas as IMPRESSORAS DO TIPO MATRICIAL DE IMPACTO, deverão atender ao seguinte cronograma de montagem tomando-se como base a quantidade utilizada no ano-calendário:

I - de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013: dispensado;

II - de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014: 20% (vinte por cento); e

III - de 1º de janeiro de 2014 em diante: 40% (quarenta por cento).

§ 2º As placas de interfaces de comunicação com tecnologia sem fio (Wi-Fi, Bluetooth, WiMax), destinadas as IMPRESSORAS DO TIPO MATRICIAL DE IMPACTO, deverão atender ao seguinte cronograma de montagem tomando-se como base a quantidade dessas placas utilizadas no ano-calendário:

I - de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013: 50% (cinquenta por cento); e

II - de 1º de janeiro de 2014 em diante: 80% (oitenta por cento).